目前我们正从以硅基集成电路为基础的信息时代向智能时代跨越，对芯片衬底材料的需求也更加多样化，异质集成材料将为后摩尔时代微电子技术的发展带来新的机遇。在光子芯片中，硅基薄膜铌酸锂异质晶圆可以实现更大带宽、更低损耗的高速光子器件。另外一方面在声学器件中，射频滤波器一直是射频前端芯片中价值量最高的元件，声表面波滤波器急需通过硅基钽酸锂薄膜异质集成提升频率和带宽，满足5G高频、大带宽的需求。同时，将宽禁带半导体与硅异质集成也是未来半导体发展的一个重要发展趋势。

本项目致力于打造国际领先的异质晶圆研发与产业化基地，2020年12月份，新硅聚合正式成立，吸引了上下游多家上市公司投资，目前注册资本约3.72亿元，总投资8.08亿元，公司坐落于上海市嘉定区。虽然仅仅成立了三年，但是我们在关键技术相关领域的研究具有非常深厚的历史积累，技术团队已获得上百项专利。过去三年多的时间里，我们的公司团队一路披荆斩棘，不断开展关键技术攻关，努力实现科研成果转化，成功开发出大尺寸硅基异质晶圆批量制造技术，建成了国际先进的异质晶圆量产线，主要产品已经实现量产和批量出货。为七十余家国内外单位提供了异质晶圆产品，特别是为国内射频与光芯片企业开发和量产高性能声光芯片，批量提供了关键异质衬底材料产品。同时，新硅聚合也获得了专精特新企业等荣誉称号。

最后，再次感谢各位专家和业内人士的肯定。未来，道阻且长，但我们坚信，科技创造未来。新硅聚合将始终坚持开拓进取，不断追求技术创新，努力成为国际领先的异质衬底研发和产业化基地，持续为我国高性能微声芯片和光芯片产业技术的自强发展和国产化供应添砖加瓦。